

第 67 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 2024 年 2 月 16 日（金） 14：00～17：40 （受付 13：30～）

場所： TKP 秋葉原カンファレンスセンター ホール 5A
Microsoft Teams ハイブリッドでの開催

1. 開会の挨拶 (14：00－14：05 5分)
2. 部品ユーザからの情報 (14：05－14：35 30分)
 - 2.1 部品ユーザからの報告／三菱電機(株)
3. 部品メーカーからの情報 (14：35－15：20 45分)
 - 3.1 2040/M105-1005X7SB104KR のデンドライト発生対策に係る報告／(株)福井村田製作所
 - 3.2 認定部品の再構築構想について／(株)タムラ製作所
 - 3.3 宇宙用パワーMOSFET 認定辞退のご連絡／富士電機(株)
- ◆休 憩◆ (15：20－15：35 15分)
4. JAXA からの情報 (15：35－16：30 55分)
 - 4.1 LAT 時の部品不具合
 - 4.2 ナノブリッジ FPGA の利用促進に向けたユーザ会の発足について／第一研究ユニット
 - 4.3 認定部品供給 50 周年表彰について
 - 4.4 2023 年度認定部品メーカーとの連携強化のための取り組み結果
5. 認定審査代行機関からの情報 (16：30－16：45 15分)
 - 5.1 認定審査代行機関からの情報／HIREC(株)
 - 5.2 認定審査代行機関からの情報／(株)エイ・イー・エス
6. 海外情報 (16：45－17：20 35分)
 - 6.1 ISTFA2023 の参加報告／(株)マクニカ
 - 6.2 CE-11/CE-12 及び NEPAG 報告
7. その他 (17：20－17：35 15分)
 - 7.1 宇宙用コンソーシアムの報告／HIREC(株)
 - 7.2 今年度/来年度のイベント紹介
8. 閉会の挨拶 (17：35－17：40 5分)

意見交換会：18：00～20：00

※資料配布

配布①：QPL/QML 部品認定計画

配布②：QTS/ADS の制改定状況